

# 博罗县园洲金富达五金制品加工厂 惠州市芯瓷半导体有限公司

## 承诺函

惠州市芯瓷半导体有限公司年产 90 万片半导体功率器件用 DPC 陶瓷基板建设项目拟选址位于博罗县园洲镇刘屋管理区绿化北路 3 号，项目总投资 1.2 亿元，总占地面积为 12000m<sup>2</sup>，总建筑面积为 6065.8m<sup>2</sup>，年产半导体功率器件用 DPC 陶瓷基板 90 万片/a。根据《博罗县园洲镇总体规划修编（2018~2035 年）》，项目所在地块已由原工业用地调整为商业用地，但由于目前当地政府尚未制定具体的规划实施方案，规划实施时间也尚未明确，博罗县园洲政府于 2021 年 7 月 12 日发函《关于惠州市芯瓷半导体有限公司用地情况说明》，同意本项目在不增加额外占地的情况下在原厂界范围内进行建设。

在此，我们郑重承诺：

(1) 若当地政府部门依据规划组织具体实施，企业将完全配合相关部门依规划要求进行搬迁，不影响规划的实施。

(2) 目前，原金富达五金制品厂尚有 2 条电镀生产线未拆除。若惠州市芯瓷半导体有限公司 DPC 陶瓷基板生产项目环境影响报告表批复后，我们承诺将在 DPC 陶瓷基板项目投产前拆除原金富达保留的 2 条电镀生产线及生产废水排污口，注销原金富达相关环保管理文件。

(3) 环评报告要求的污染防治措施和环境风险防范措施未按要求落实，未按规定与资质单位签订危废处置协议前不投产。





如上若有违反，由此造成的后果由我司自行承担。

特此证明。

博罗县园洲金富达五金制品  
加工厂 (盖章)

2022年4月5日



惠州市芯瓷半导体有限公司  
(盖章)

2022年4月5日

